

포토마스크보호용점착필름  
Emulsion Protection Film



키모텍트™  
액상레지스트용보호필름  
For Liquid Solder Resist



기본재료 두께 Base Film Thickness	점착 두께 Adhesive Thickness	세퍼레이터 두께 Release Liner Thickness
6 μm	2 μm	25 μm

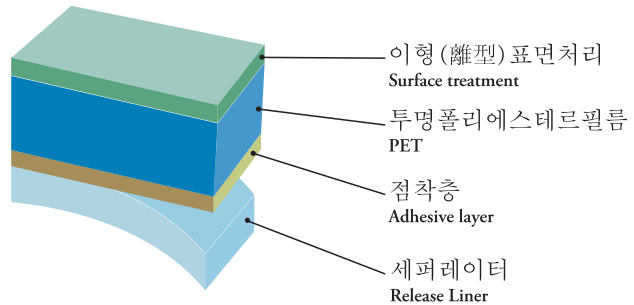
액상레지스트가 부착이 어려워져 클리닝도 용이해지고  
끈적음이 남지 않아 재박리가 가능  
키모텍트 액상레지스트용 스탠다드 타입

PA8X can be easily removed from the surface of the phototools and is repeelable without any remnants of adhesive.  
PA8X is a standard type for the Liquid Solder Photo Resist Series.



기본재료 두께 Base Film Thickness	점착 두께 Adhesive Thickness	세퍼레이터 두께 Release Liner Thickness
6 μm	2 μm	25 μm

매트타입을 사용함으로써 밀착성과 진공펌프성이 향상  
A matted surface improves adhesion and vacuum pressure.



특성 Properties

	PA8X	PA8XM
전광선투과율(%)*1 Total Light Transmittance	92.9	92.2
평행광투과율(%)*1 Parallel Light Transmittance	90.8	85.6
자외선투과율*2(%/365nm) UV Light Transmittance	87.9	89.5
자외선투과율*2(%/420nm) UV Light Transmittance	87.4	90.0
Haze(%)*1	2.1	7.2
점착력 (대PET) Adhesive Force for PET	2.5N/25mm	2.6N/25mm

\*1: JIS-K7105에 준해서 측정함. 세퍼레이터는 포함되어 있지 않습니다.

\*2: 시마즈제작소재 UV-3101PC로 측정함. 세퍼레이터는 포함되어 있지 않습니다.

\*1: JIS-K7105 without Release Film. \*2: Simazu UV-3101PC without Release Liner.